

厦门通士达照明有限公司3D SPI招标报价书

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

报价日期

序号	物料编码	名称	规格型号	单位	含税点	含税单价	品牌	交期	技术要求
1		3D SPI		1台					1.最大基板尺寸：L450*W490mm；2.最小基板尺寸：L50*W50mm；3.基板厚度尺寸：0.4-4mm；4.工业相机：12M,像素4096*3072；5.投影头:2个；6.分辨率：X、Y方向：12±0.5um；高度：0.37um；7.重复精度：高度小于1um(4Sigma)；体积：小于1%（5Sigma）；8.最小焊盘间距：100um（焊膏高度为150um的焊盘为基准）；9.弯曲PCB最大测量高度±2mm；10.最小测量大小：长方形：150um；圆形：200um；11.最小检查01005器件焊盘。

若上述物料型号规格描述模糊，报价时请注明所报价物料的型号规格；如有最小起定量，请备注说明

质量要求：符合国家标准或行业标准

付款方式：见票30天转帐，如有特殊情况需注明

交货方式：货到工厂指定仓库（厦门市同安区西柯镇美溪道676号）

备注：1. 以上报价含运费+13%增值税发票